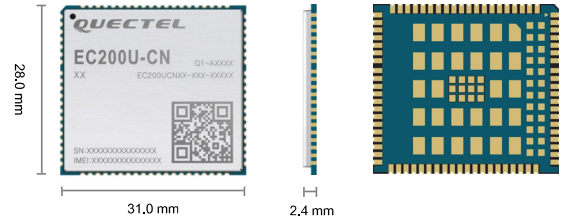


Quectel EC200U-CN

LTE Cat 1 模块

专为 M2M 和 IoT 应用而设计



EC200U-CN 是移远通信最新推出的 LTE Cat 1 无线通信模块，支持最大下行速率 10 Mbps 和最大上行速率 5 Mbps，超高性价比；同时在封装上兼容移远通信多网络制式 LTE Standard EC25 系列、EC21 系列、EC20-CE、EC20-CN、EC200T 系列、EC200S 系列、EG25-G、EG21-G 以及 UMTS/HSPA+ UC200T 系列模块，实现了 3G 网络到 4G 网络之间的无缝切换。EC200U-CN 还支持标准的 Mini PCIe 封装，以满足不同行业产品应用需求。

EC200U-CN 采用镭雕工艺，镭雕工艺具有外观更好看、金属质感强、散热更好、信息不容易被抹除、更能适应自动化需求等优点。

EC200U-CN 内置丰富的网络协议，集成多个工业标准接口，并支持多种驱动和软件功能（适用于 Windows 7/8/8.1/10、Linux 和 Android 等操作系统下的 USB 驱动），极大地拓展了其在 M2M 领域的应用范围，如 POS、POC、ETC、共享、数据卡、能源控制、安防以及工业级 PDA 等。



主要优势

- ✓ 专为 M2M 和 IoT 应用而设计的 LTE Cat 1 无线模块
- ✓ 多网络制式覆盖
- ✓ 功能接口丰富
- ✓ 支持内部 Codec
- ✓ 内置 GNSS
- ✓ 支持蓝牙
- ✓ 支持 Wi-Fi Scan 定位
- ✓ 支持 FOTA 远程升级功能
- ✓ 超高性价比



LTE Cat 1
最大 10 Mbps（下行）
最大 5 Mbps（上行）



LCC 封装



内嵌多种网络协议



Wi-Fi Scan



蓝牙



GNSS



FOTA



Quectel 增强型
AT 命令



USB 2.0 高速接口

Quectel EC200U-CN

LTE Cat 1 模块

专为 M2M 和 IoT 应用而设计

频段:

LTE-FDD: B1/B3/B5/B8
LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
GSM: 900/1800 MHz

数据

LTE-FDD:
最大 10 Mbps (下行) / 最大 5 Mbps (上行)
LTE-TDD:
最大 8.96 Mbps (下行) / 最大 3.1 Mbps (下行)
GSM:
最大 85.6 kbps (下行) / 最大 85.6 kbps (上行)

接口

1 个 USB 2.0 高速接口
1 个数字语音 PCM 接口
1 组模拟音频接口
1 个 1.8/3.0 V (U)SIM 接口
2 个 UART 接口 (主串口和调试串口)
3 个 ADC 接口
2 个 I2C 接口
1 个 LCD 接口
2 个 SDIO 接口 (用于连接 SD 卡*和 Wi-Fi)
3 x 4 矩阵键盘
RESET (低电平有效)
PWRKEY (低电平有效)
3 个天线接口:
主天线/GNSS 天线/蓝牙天线

突出特性

FOTA (空中下载固件升级)
Wi-Fi Scan 定位
(U)SIM 卡检测
蓝牙
GNSS
用于连接 SD 卡*和 Wi-Fi 功能的 SDIO 接口

电气参数

输出功率:
Class 3 (23 dBm \pm 2 dB), LTE-FDD 频段
Class 3 (23 dBm \pm 2 dB), LTE-TDD 频段
Class 4 (33 dBm \pm 2 dB), EGSM900 频段
Class 1 (30 dBm \pm 2 dB), DCS1800 频段
功耗:
12 μ A @ 关机
1.7 mA @ LTE 休眠 (PF = 128)
1.4 mA @ LTE 休眠 (PF = 256)
28 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 连接)
13 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 断开)
灵敏度:
FDD B1: -98.5 dBm
FDD B3: -99.6 dBm
FDD B5: -99.2 dBm
FDD B8: -98.7 dBm
TDD B34: -99.2 dBm
TDD B38: -98.8 dBm
TDD B39: -99.5 dBm
TDD B40: -99.4 dBm
TDD B41: -98.9 dBm
EGSM900: -109.5 dBm
DCS1800: -109.5 dBm

软件特性

USB 串行串口驱动:
Windows 7/8/8.1/10,
Linux 2.6~5.10,
Android 4.x~10.x
GNSS 驱动: Android 4.x~10.x
RIL 驱动: Android 4.x~10.x
USB MBIM 驱动:
Windows 8/8.1/10,
Linux 3.18~5.10
RNDIS 驱动:
Windows 7/8/8.1/10,
Linux 2.6~5.10

ECM 驱动: Linux 2.6~5.10

NCM 驱动: Linux 2.6~5.10

协议栈:

TCP/UDP/PPP/NITZ/PING/FILE/MQTT/NTP/HTTP/
HTTPS/SSL/FTP/FTPS/SMT*P*/SMT*PS*/CMUX*/
MMS*

一般特性

工作温度范围: -35 $^{\circ}$ C ~ +75 $^{\circ}$ C
扩展温度范围: -40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C
模块尺寸: 28.0 mm \times 31.0 mm \times 2.4 mm
重量: 约 4.1 g
LCC 封装
供电电压: 3.3~4.3 V, 典型值 3.8 V
带宽: 1.4/3/5/10/15/20 MHz
3GPP TS 27.007、27.005 定义的命令,
以及移远通信增强型 AT 命令

认证

强制认证:
SRRC/NAL/CCC (中国)

* 表示正在开发中